

何鹏

工学博士

先进焊接与连接国家重点实验室主任助理

教授；博士生导师

新世纪优秀人才

+86-451-86402787

hepeng@hit.edu.cn

主要研究方向

钎焊、微连接及可靠性基础理论与实际应用技术

社会兼职

1. 中国焊接标准化委员会钎焊分委会副主任
2. 中国焊接学会钎焊及特种连接专业委员会副主任

主要学术成果

发表的主要学术论文

1. **P. He**, D. Liu, E.J. Shang, M. Wang. Effect of mechanical milling on Ni-TiH₂ powder alloy filler metal for brazing TiAl intermetallic alloy: The microstructure and joint's properties. *Materials Characterization*, 2009, 60(1):30~35
2. H. Liu, **P. He**, J.C. Feng. Kinetic study on nonisothermal dehydrogenation of TiH₂ powders. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2009, 34(7):3018~3025
3. **P. He**, D. Liu. Mechanism of forming interfacial intermetallic compounds at interface for solid state diffusion bonding of dissimilar materials. *Materials Science and Engineering A*, 2006, 437(2):430~435
4. **P. He**, J.C. Feng, W. Xu. Microstructure and kinetics of induction brazing TiAl-based intermetallics to steel 35CrMo using AgCuTi filler metal. *Materials Science and Engineering A*, 2006, 418(1): 53~60
5. **P. He**, J.C. Feng, W. Xu. Interfacial microstructure of induction brazed joints of TiAl-based intermetallics to steel 35CrMo with AgCuNiTi filler. *Materials Science and Engineering A*, 2005, 408(1-2):195~201
6. **P. He**, X. Yue, J.H. Zhang. Hot pressing diffusion bonding of a titanium alloy to a stainless steel with an aluminum alloy interlayer. *Materials Science and Engineering A*, 2008, 486(1-2):171~176
7. Y.L. Li, **P. He**, J.C. Feng. Interface structure and mechanical properties of the TiAl/42CrMo steel joint vacuum brazed with Ag-Cu/Ti/Ag-Cu filler metal. *Scripta Materialia*, 2006, 55(2):171~174
8. 谢凤春, **何鹏**, 冯吉才. 钛基非晶态钎料钎焊高强石墨与铜的界面特征. *焊接学报*. 2008, 29(3): 73-76
9. 王颖, **何鹏**, 冯吉才; 张丽霞; 顾小龙; 王大勇. 接头形式对陶瓷/金属连接残余应力的影响. *焊接学报*. 2007, 28(4): 13-16
10. 姜晓飞, **何鹏**, 冯吉才、石常亮张洪涛. CMT法 30CrMnSi 钢板表面熔敷 CuSi₃ 接头组织结构特征. *焊接学报*. 2007, 28(2): 47-50
11. 史建卫, **何鹏**, 钱乙余, 袁和平. 焊膏印刷技术及无铅化对其的影响. *电子工业专用设备*. 2006, 12: 29-38
12. 石常亮, **何鹏**, 冯吉才、张洪涛. 铝/镀锌钢板 CMT 熔钎焊界面区组织与接头性能. *焊接学报*. 2006, 27(12): 61-64
13. **何鹏**, 赵智力, 钱乙余. Sn-Bi-Ag-Cu 钎料波峰焊焊点的剥离现象. *中国有色金属学报*. 2005, 15(7): 993-999
14. 史建卫, **何鹏**, 钱乙余, 袁和平. 无铅化 SMT 质量检测技术. *电子工艺技术*. 2005, 26(3): 140-146

授权的国家发明专利

1. 冯吉才、**何鹏**、谢凤春、张九海, 碳铜复合结构换向器钎焊成型方法, 专利号: 200710072472.8
2. 冯吉才、**何鹏**、谢凤春、张九海, 碳铜复合结构换向器钎焊一次成型方法, 专利号: 200710072470.9
3. 许桂法、**何鹏**、张理成、冯吉才、李卓然, 一种高塑性铜磷钎料及其制备方法, 专利号: 200410044078.X
4. 冯吉才、**何鹏**、李玉龙、张九海, 一种 TiAl 合金增压涡轮与钢轴的高强度连接方法, 专利号: CN200510010401.6
5. **何鹏**、冯吉才、钱乙余、邓志容, 一种中温 Ag 基钎料及其制备方法, 专利号: 200410044108.7
6. 冯吉才、**何鹏**、钱乙余、张九海、张秉刚, 钛铝基合金与钢的一种活性复合梯度阻隔扩散焊接方法, 专利号: 02133239.8

撰写的著作

马鑫, **何鹏**. 电子组装中的无铅软钎焊技术. 哈尔滨工业大学出版社. 2006 年 6 月